

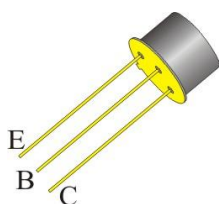
3CK5415 型硅 PNP 高频小功率开关晶体管

1、特性

芯片采用硅外延平面结构，器件采用 A3-02B 型金属封装和 SMD-0.2、UA 型金属陶瓷封装。

器件具有特征频率高、开关时间小，体积小、重量轻，可靠性高的特点。

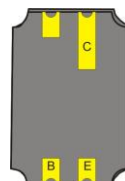
器件的静电放电敏感度为 4000V，A3-02B 典型重量 1.13g，SMD-0.2 典型重量 0.45g，UA 典型重量 0.12g。



A3-02B 型



SMD-0.2



UA

注：SMD-0.2 封装产品型号后缀加“U”标识，UA 封装产品型号后缀加“UA”标识。

2、质量等级及执行标准

G、G+级：Q/RBJ1001QZ，QZJ840611；

A3-02B 型：JP、JT 和 JCT 级，ZZR-Q/RBJ20056-2009，GJB33A-1997；

CAST 级，CASTPS10/278—2016，GJB33A-1997；

YA、YB、YC 级（A3-02B）：Q/QJA20104/184-2021，Q/QJA20104A-2017。

UA 型：JP、JT 和 JCT 级，Q/RBJ 30022-2015，GJB33A-1997。

3、最大额定值

器件额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

型 号	$P_{\text{tot1}}^{\text{a}}$ mW	$P_{\text{tot2}}^{\text{b}}$ W	I_{CM} A	V_{CBO} V	V_{CEO} V	V_{EBO} V	$T_{\text{stg}}, T_{\text{j}}$ $^{\circ}\text{C}$
3CK5415	750	10	1	200	200	6	-65~200
^a P_{tot1} 为 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ，不加散热片时的最大额定功率； $T_A>25^{\circ}\text{C}$ 时,按 4.29mW/ $^{\circ}\text{C}$ 线性地降额。							
^b P_{tot2} 为 $T_C=25^{\circ}\text{C}$ 时的最大额定功率； $T_C>25^{\circ}\text{C}$ 时,按 57.1mW/ $^{\circ}\text{C}$ 线性地降额。							

4、主要电特性

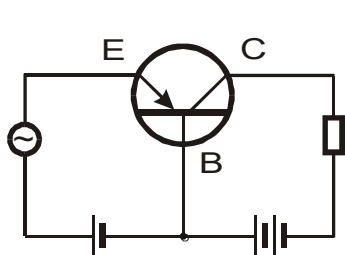
主要电特性（除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

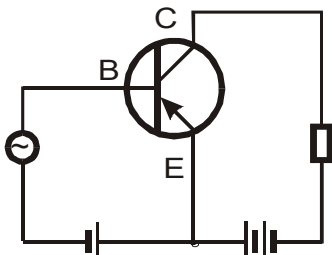
符 号	参 数	数 值			单 位
		最小值	典型值	最大值	
I_{CBO1}	$V_{CB}=-175V$	—	1	50	μA
I_{CBO2}	$V_{CB}=-200V$	—	10	500	μA
I_{CEO1}	$V_{CE}=-150V$	—	1	50	μA
I_{CEO2}	$V_{CE}=-200V$	—	0.5	1	mA
I_{EBO}	$V_{EB}=-6V$	—	0.5	20	μA
h_{FE1}	$V_{CE}=-10V, I_C=1.0mA$	15	—	—	—
h_{FE2}	$V_{CE}=-10V, I_C=50mA$	30	—	120	—
$V_{BE(sat)}$	$I_C=50mA, I_B=5mA$	—	-0.8	-1.2	V
$V_{CE(sat)}$	$I_C=50mA, I_B=5mA$	—	-0.3	-1.2	V
f_T	$V_{CE}=-10V, I_C=5mA, f=10MHz$	15	50	75	MHz
C_{ob}	$V_{CB}=-10V, I_E=0, f=1MHz$	—	10	15	pF
t_{on}	$I_C=50mA, I_B=5mA$	—	0.2	1	μs
t_{off}	$I_C=50mA, I_B=5mA$	—	1	10	μs

5、典型电路应用图

器件在电子线路中主要有两种接线法，如图所示：

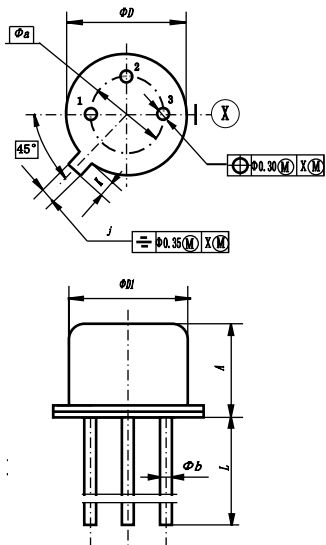


共基极接线法



共发射极接线法

6、外形尺寸



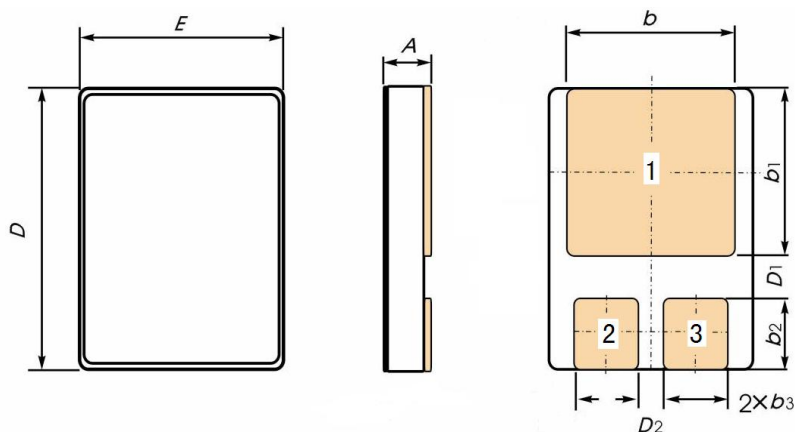
单位为毫米

尺寸符号	数 值		
	最 小	典型值	最 大
A	6.10	—	6.80
Φa	—	5.08	—
Φb	0.407	—	0.508
ΦD	8.64	—	9.39
ΦD_1	8.01	—	8.50
j	0.712	0.787	0.863
K	0.40	—	1.14
L	12.5	—	25.0

引出端极性：1—发射极，2—基极，3—集电极

A3-02B 外形尺寸

单位为毫米

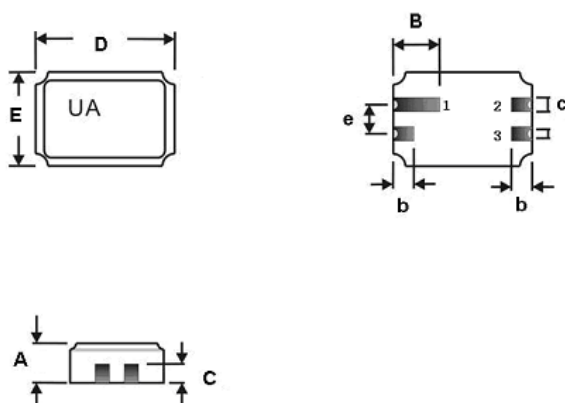


尺寸符号	数值	
	最小值	最大值
<i>A</i>	2.41	3.34
<i>b</i>	4.85	5.45
<i>b</i> ₁	4.40	5.15
<i>b</i> ₂	1.75	2.15
<i>b</i> ₃	1.85	2.25
<i>D</i>	7.67	8.38
<i>D</i> ₁	0.50	—
<i>D</i> ₂	0.60	—
<i>E</i>	5.13	5.84

引出端极性：1—集电极，2—发射极，3—基极

SMD-0.2 外形尺寸

单位为毫米



尺寸符号	数值	
	最小值	最大值
<i>A</i>	1.50	1.95
<i>B</i>	1.78	2.28
<i>b</i>	0.78	1.25
<i>C</i>	0.70	1.07
<i>c</i>	0.52	0.75
<i>D</i>	5.42	5.75
<i>E</i>	3.65	3.96
<i>e</i>	1.14	1.39

引出端极性：1—集电极，2—发射极，3—基极

UA 外形尺寸

7、使用和维护

7.1 器件的安装

安装质量的好坏对器件的可靠性影响很大。

A3-02B 型封装，引出端直径 0.407mm~0.508mm。在安装、测试等过程中不允许多次折弯和施应力，否则易造成引脚折断或玻璃绝缘子裂缝，影响其密封性。SMD-0.2、UA 型金属陶瓷封装，在安装、测试等过程中轻拿轻放，避免碰撞、重物碾压，否则易造成陶瓷金属裂缝，影响其密封性。

焊接安装时，器件允许耐焊接热的条件是温度 260℃ 下不超过 10 秒；浸锡温度不超过 260℃，时间不超过 10 秒。

7.2 器件的使用

测试或筛选时应严格按照规定条件、方法进行，应使用合格的设备、仪器仪表，并对其进行校验；操作人员必须持证上岗，必要时要进行专门培训。

严禁超规范使用，注意防潮、防尘，严禁裸手直接接触器件。

测试设备、仪器仪表可靠接地。

测试过程中应采取静电防护措施。

如发生不可预期情况或误操作造成器件损坏等情况，请与供应商联系。